

安集微电子科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：安集科技 股票代码：688019 编号：2025-018、019、020

投资者关系 活动类别	<div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div>
参与单位名称	中信建投、盘京投资、国泰基金、惠升基金、中泰证券、光大保德信基金、华宝基金、平安养老、摩根资管、中金公司、易方达、景顺长城基金、国金证券、华商基金、开源电子、合远基金等
时间	2025 年 12 月 22 日-2025 年 12 月 25 日
地点	公司会议室
公司 接待人员姓名	总经理 Zhang Ming 副总经理、董事会秘书 杨逊 财务负责人 刘荣
投资者关系 活动 主要内容介绍	<div>一、公司介绍： 介绍公司近况。</div> <div>二、问答环节主要内容： Q：公司如何看待国内目前的竞争格局，如何应对？ A：竞争的存在是商业发展规律，相信良性、积极的竞争环境可以使整个行业有更好的发展。对于安集而言，公司会持续专注自己的成长，凭借现有技术积累和创新迭代能力，持续与客户深度合作保持市场地位稳固，并将竞争压力转化为优化动力，从技术研发、客户服务质量、团队建设等多个方面进一步提升，巩固核心竞争力。 Q：公司竞争优势有哪些？ A：首先在技术能力方面，通过 20 年的研发积累，依托完整的知识产权体系，公司完成了“3+1”技术平台的搭建，部分技术已达到国际先进水平，研发能力和技术水平具</div>

有竞争力；其次，在服务模式方面，公司更加贴近市场和客户需求，响应速度快、灵活性高，能够为客户提供良好、紧密、一站式的服务；此外，公司布局的核心原材料自主可控供应能力，提升了公司的产品性能和供应安全保障，进一步加强公司的竞争优势。

Q：公司原材料的研发和应用进展？

A：公司对于原材料自主可控的品类是有选择性的，重点在于强化核心原材料自主可控的能力，提升自身产品的稳定性和竞争力，并确保战略供应。截至目前，公司参与研发的多款硅溶胶已在公司多款抛光液产品中应用，实现销售；自产氧化铈磨料应用在公司产品中测试论证进展顺利，多款产品已通过客户端的验证并实现量产供应，并在提升产品技术水平方面取得进展。

Q：先进制程的发展，会影响贵司 CMP 抛光液的需求量吗？

A：随着制程节点的进步，多层布线的数量及密度增加，CMP 工艺步骤增加，其耗用量也会相应增加，同时，更先进的逻辑芯片工艺可能会要求抛光新的材料，为抛光液带来了更多的增长机会。同样地，对于存储芯片，随着由 2D NAND 向 3D NAND 演进等技术变革，使 CMP 工艺步骤也会随之增加，带动 CMP 抛光材料的需求量。

Q：当前存储芯片价格上涨的背景下，Fab 厂可能会进行产能调整或扩产。请问贵公司未来是否可能会遇到产能紧张的问题？

A：公司会结合中长期战略方向、业务及市场情况规划产能布局，把握产线建设和投产的节奏，充分利用上海浦东金桥、宁波北仑及上海化工区三大生产基地差异化特点，确保稳定供应的同时满足新的增长需求。

Q：我们注意到，抛光液产品向功能性湿化学品领域拓展，客户端的导入进程相对迅速。目前在开发的电镀液产品，其研发进展与供应能力目前处于怎样的阶段，电镀液是否和前两类产品有差异？

A：关于电镀液及添加剂产品，不同于抛光液、清洗液等耗材，其会长期留存于晶圆内部，直接或间接影响芯片的性能，因此客户在供应商选择上更为审慎，验证和放量周期可能在前期会比预期长一些。公司多年前正式启动电镀液及添加剂研发以来，仅用几

年的时间便完成核心技术突破与客户认可，当前产品已覆盖多种电镀液及添加剂品类。电镀液本地化供应进展顺利，持续上量；集成电路大马士革电镀液及添加剂、先进封装锡银电镀液及添加剂、硅通孔电镀液及添加剂开发及验证按计划进行。

Q：台湾业务目前的发展情况如何？在台销售的产品是在何地生产的？

A：公司在台湾有注册成立全资子公司，我们在持续投入并深化本地布局。目前，台湾设立了本地实验室，管理团队和研发团队规模也在稳步扩大，整体技术实力与服务能力正处于持续提升阶段。运营方面，目前在台湾市场销售的产品主要由大陆生产基地制造生产。

Q：公司功能性湿电子化学品的定位和目前进展情况如何？

A：对于功能性湿电子化学品板块，公司致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的产品和解决方案，持续拓展产品线布局，目前已涵盖刻蚀后清洗液、光刻胶剥离液、抛光后清洗液及刻蚀液等多种产品系列。目前，部分产品已经进入了规模化增长阶段，公司将持续拓展产品线布局，逐步提升功能性湿电子化学品的市场份额，尽快成为国内市场的主流供应商。

Q：从三季报来看，研发支出增长较快，可否介绍下具体情况？

A：研发费用增长主要源于研发项目数量多、活动频繁，从侧面也体现公司与客户的深度互动增强；另一因素是股份支付费用下半年摊销较多所致。公司作为研发驱动型企业，随着市场和客户需求的变化，会有很多研发投入的需要，未来会持续增加研发投入，研发费用率可能会随着营业收入的增长有小幅度的波动，但研发费用的绝对值会保持一定的增长。

Q：公司先进制程及成熟制程毛利率如何？

A：公司三大产品平台项下拥有众多不同产品，不同产品间会因为不同制程、不同应用工艺等而产生一定范围的毛利率差异。同时，随着不同产品的上量节奏原因，公司综合毛利率会在短期内小幅波动。长远来看，公司毛利率将以“长期稳健”为核心导向，会将综合毛利率控制在健康区间内，以支撑后续研发投入与产能布局。

	<p>Q：公司前五大客户销售占比较前几年有所调整的原因是什么？</p> <p>A：近几年，公司依循既定发展路径与市场拓展规划高效推进各项计划，在新订单、新客户、新应用的获取及各产品导入等方面均取得显著进展，产品结构和客户分布得到进一步拓展，市场渗透度在深度与广度上同步上升，使得前五大客户的销售收入在绝对值稳健增长的情况下，公司的客户结构也得到进一步优化。</p> <p>Q：公司可转债近期是否会强赎？</p> <p>A：公司于 2025 年 10 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议决议，2026 年 2 月 1 日后若“安集转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将另行召开会议决定是否行使“安集转债”的提前赎回权利。</p>
附件清单 （如有）	无
日期	2025 年 12 月 25 日